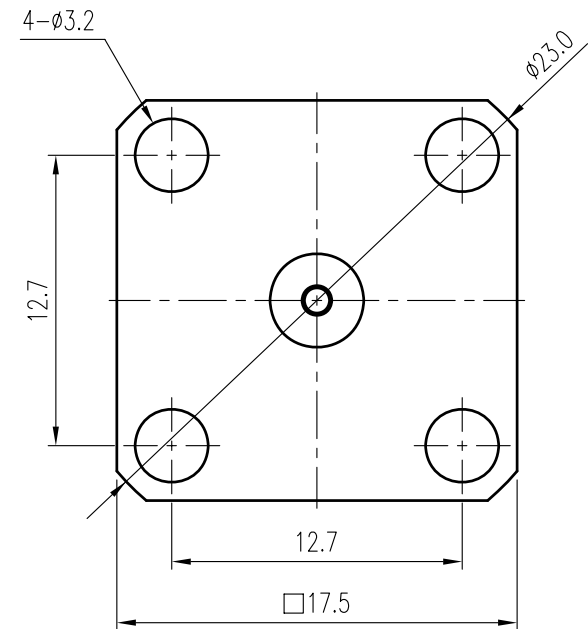
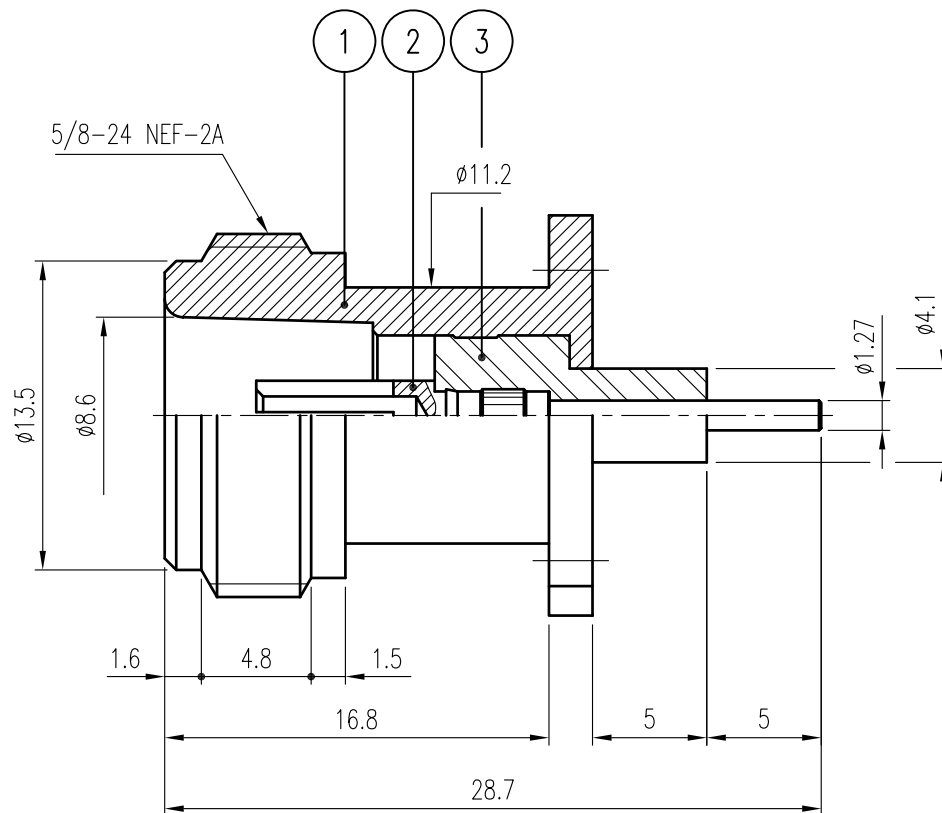


수 정 내 용									
ST	가공								
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
△1	[설번처리No.201808-0001] 절연체 구성 변경 공용화 작업 - 컴텍사 요청내용	김인철		2018.	08.	07			
△									



△1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02103-N/1 DIN01063-N/1 (D8288)
	2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate 7μm	DCT01148-5/1 (E8416)
	1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate 6μm	DBD01510-5/1 (D8422)
	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	품번		품명		수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2018. 08. 07.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-947-8015 Fax : 82-32-947-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
	검도							
재질	재료		I. C. KIM			도명 N50 SOLDER END JS-4H		
열처리	작성부서							
연구소								
보호파막처리	적도		3/1	단위 mm	중량	A4	도번 CN00836-7/1	